

연수 제안서

연구 분야	외부자극 감응형 분자기계소재 개발 및 스트레처블 전자센서 소자로의 응용
연구 과제명	외부자극 감응형 스마트 분자기계결정 소재 설계 플랫폼 개발
연수 제안 업무	분자기계소재의 개발 및 3D 프린팅 기법을 활용한 스트레처블 전자센서소자의 개발
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 인턴 연구원 - 2023.01.01. ~ 2022.09.30.</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p>소재 개발</p> <ul style="list-style-type: none">-외부자극 감응형 분자기계전자소재 합성-외부자극 감응형 분자기계전자소재와 저차원 나노소재의 복합화 <p>소자 개발</p> <ul style="list-style-type: none">-3D 프린팅 기법을 활용한 분자기계전자소재 기반 스트레처블 전자센서소자 개발 연구	
소속 부 서 : 기능성복합소재연구센터	
연수 책임자 : 박 상 규	